

**Dk 3.4 Df 0.003
@12GHz**

Tg (DMA) 250°C

**T320(銅付)
>120分**

Applications
ネットワーク/ワイヤレス通信

ICTインフラ機器、高速通信機器(ハイエンドサーバ、ルータ、光ネットワーク、スイッチ)、高多層基板 など



Halogen-free
MEGTRON6

Laminate

R-5375(N)* R-5375(E)

Prepreg

R-5370(N)* R-5370(E)

*Low Dk glass cloth type

ハロゲンフリー超低伝送損失多層基板材料

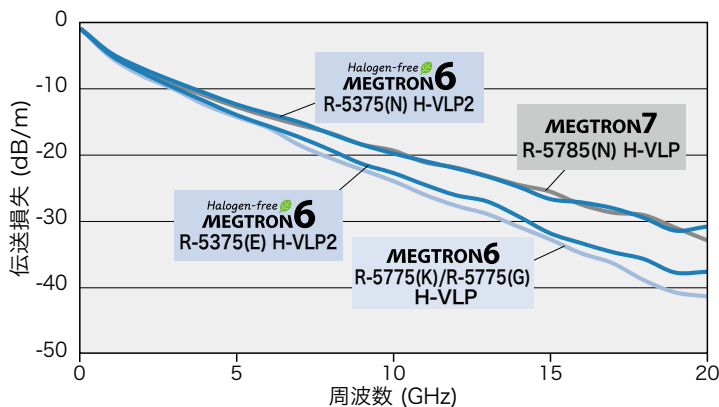
超高性能サーバやルータ向けのデファクトスタンダード材料にハロゲンフリーを付与。MEGTRON6を超える低伝送ロスを実現し、超高性能サーバやルータの性能向上に貢献

Better



Ultra Low Loss
Very Low Loss
Low Loss
Mid Loss

伝送損失比較



高多層耐熱性

評価結果

ドリル径	φ0.3mm	
TH壁間距離	0.3mm	0.5mm
Halogen-free MEGTRON6 R-5375(E)	pass	pass

評価条件

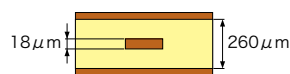
260°Cリフロー×10回

構成

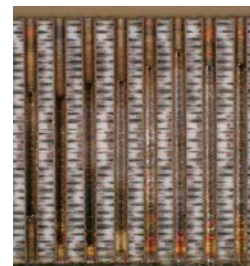
32層

板厚: 4.5mm

構成



配線長さ	200mm, 100mm
配線幅	125μm
インピーダンス	50Ω
内層銅箔処理	表面処理なし
コア材	0.13mm
プリプレグ	#2116 56% x 1ply



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	Halogen-free MEGTRON6 R-5375(N) Low Dk glass cloth	Halogen-free MEGTRON6 R-5375(E) E glass cloth	MEGTRON6 R-5775(K)/R-5775(G) E glass cloth	
ガラス転移温度(Tg)	DMA (1Hz)	A	°C	250	250	210* ¹	
熱膨張率	TMA (Z方向)	50-260°C	%	1.7	1.7	2.9	
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120	>120	
T320(銅付)				>120	>120	50	
比誘電率(Dk)	12GHz	平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	3.4	3.6	
誘電正接(Df)					0.003	0.004	0.004
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.6* ²	0.6* ²	0.8* ³

試験片の厚さは0.75mmです。

※1 10Hz ※2 H-VLP2銅箔 ※3 H-VLP銅箔

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。